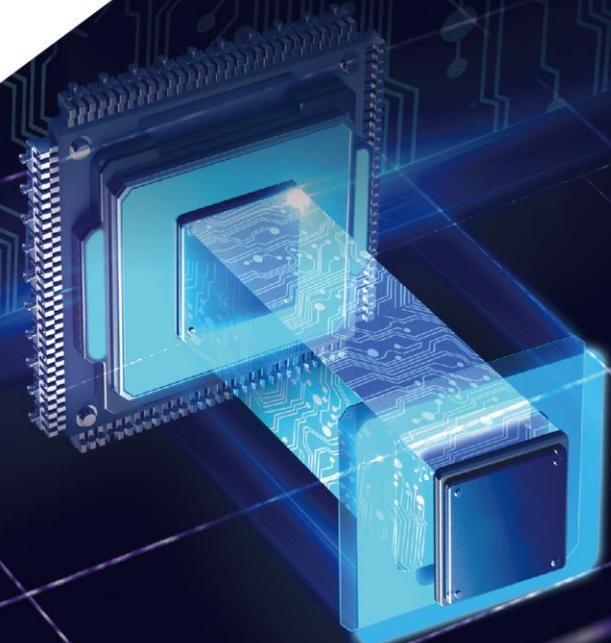
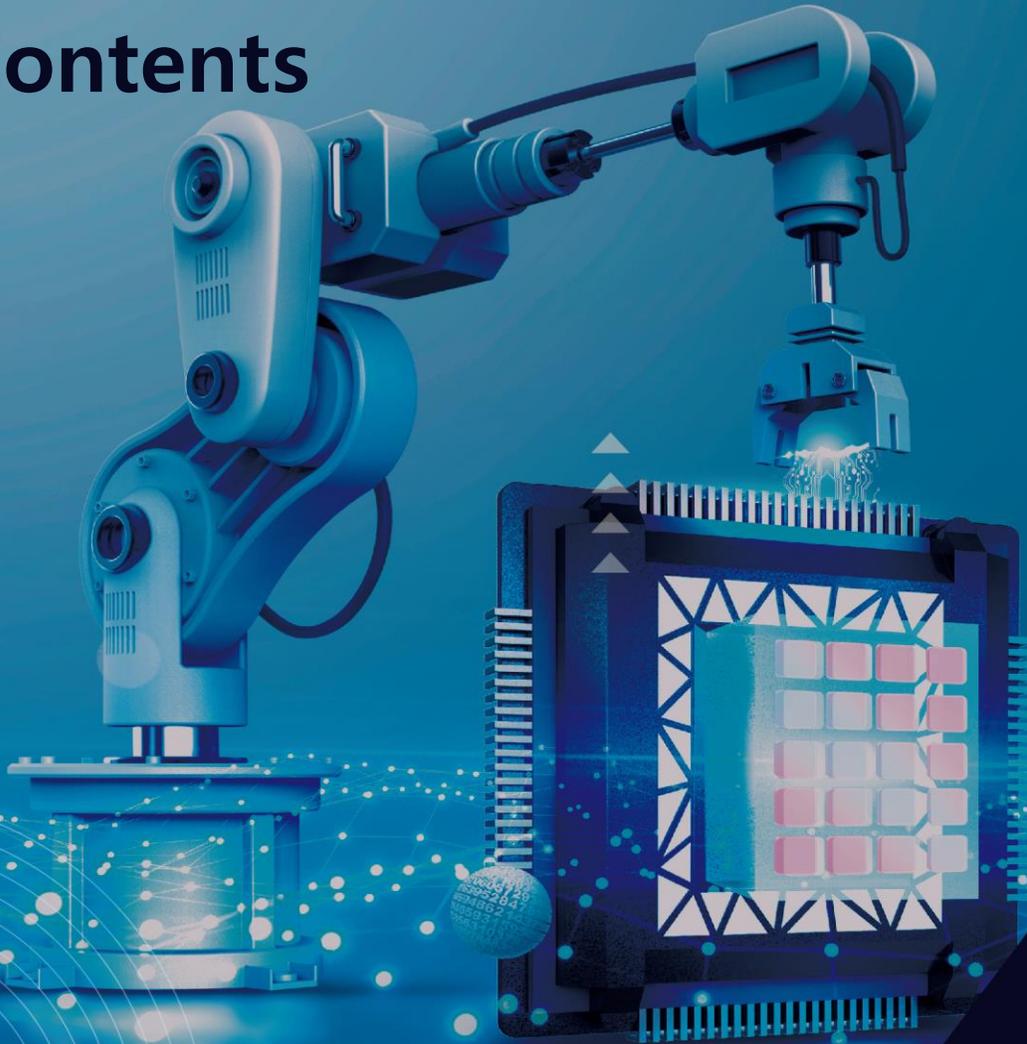


# 2023 첨단산업 인재양성 부트캠프사업 설명회



# Contents



## I 사업소개

## II 교육프로그램

II-1 교육과정

II-2 이수체계 및 제도개선

II-3 학생지원

## III 사업단 소개 및 향후일정

# intro 첨단산업 인재양성 부트캠프 사업소개

## 사업목표

- 첨단분야 급증하는 인력수요에 대응하여 신속한 인재 공급 추진
- 대학이 기업과 공동으로 취업희망자(대학생) 대상 현장성 높은 **단기 집중교육 프로그램을 개발.운영하고 취업 연계 지원**

## 사업내용

- (지원기간) 5년(3+2), '23년 선정대학('23~'27)
- (예산규모) '23년, 150억원
- 선정된 대학들은 참여기업과 공동으로 수준별 단기 집중 교육과정을 운영해 대학별 연간 최소 100명 이상의 실무 인력을 양성



구분	대학명(가나다 순)	주요 참여기업	교육분야
대학 (5교)	가천대	원익IPS, 필옵틱스	설계,소자분석 평가
	강릉원주대	엠코테크놀로지코리아,미코세라믹스	소재,장비,공정
	<b>단국대</b>	<b>에드워드코리아,온세미컨덕터코리아</b>	<b>설계,공정·소자,소재</b>
	한국공학대	AP시스템,테스	설계,공정장비
	한국해양대	제엠제코,에이앤아이	전력반도체
전문 대학 (5교)	경기과학대	실리콘마이터스,케이엠테크	측정검사 품질관리,설계검증
	동양미래대	스텍칩팩코리아,이오테크닉스	검사·측정,장비
	두원공과대	HB솔루션,씨앤지하이테크	장비 유지보수,장비 설계
	오산대	제우스,에이치티씨솔루션	장비제작, 유지보수
	울산과학대	DB하이텍,에이블	설비 유지보수,전력반도체

# I 사업소개



## “반도체 산업 선진 글로벌 리더 양성”

비전

목표

산업계 맞춤형

+

반도체 소재·공정/소자·설계 첨단분야 융합인재 양성



교육과정 혁신



반도체  
소재·공정/소자·설계  
교과목의 공유를 통한  
반도체 전문 인력 육성

교육 인프라 혁신

소재·공정/소자·설계  
몰입형 교육과정 및  
콘텐츠 개발

대학이 보유 중인 산학  
연계 인적 자원 활용  
(교수, 외부전문가, 네트워크 등)

대학이 기 보유중인 교  
육 자원 활용 및 고도화  
(보유 시설 및 인프라)

대학의 강점을 활용한  
유무형의 자원 및  
교육 개발과 확산

기대효과

대학-지역간 연계를 통한  
자원 및 인적 자원 투자의  
선순환 생태계 구축

지·산·학 연계를 통한  
반도체 소재·공정/소자·설계  
분야 산업 활성화 및 사회공헌

반도체 소재·공정/소자·설  
계 분야 국가경쟁력 제고

# I 사업소개

교육 인프라 구축 및 개선 계획

## 1 반도체 클린룸 구축 계획

| 죽전 공용 클린룸 구축(2023년~2025년)

- 첨단 반도체 분야의 교육, 연구를 위한 공용 클린룸의 3단계 구축 및 고도화



## 2 교육 인프라 구축 및 개선

| 대학 인프라 개선 활용 + 교육 인프라 구축

- 실습실, 강의실, 실험실을 사업기간동안 단계별 개선 및 구축



**반도체 전문인력양성 사업단**

실습실 개선 및 구축 + 강의실 개선 및 구축 + 실험실 개선 및 구축

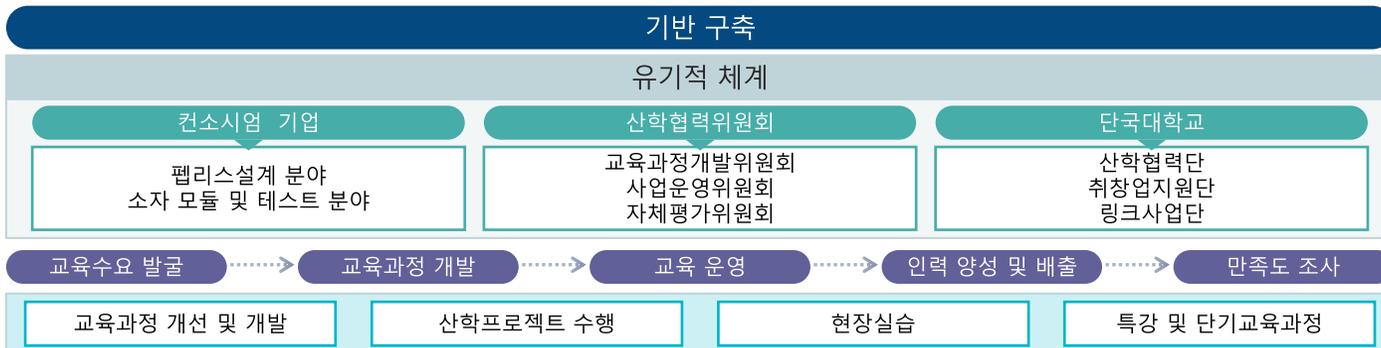
반도체 분야 교육, 연구를 위한 최신 기자재 도입 및 업그레이드

## 신규기자재 도입 및 업그레이드 3

| 반도체 소재·소자/공정·설계를 위한 장비도입

- PBL기반의 교육을 위한 인프라 구축

# I 사업소개



## 실무 맞춤형 교육을 통한 인재 양성

> 참여기업과의 협업을 통해 교육과정 정비, 교과목 개발, 산학프로젝트 공동운영, 산업체 현장실습, 전문가 특강 및 멘토링을 통해 전공자와 비전공자를 아우르는 실무 중심의 교과목을 운영해 차세대 반도체 분야의 전문인재 양성

사명	매출규모	분야	상장
와이씨켄 주식회사	82,350 백만원	Photoresist, Rinsing Solution	상장사
스텨코	313,480 백만원	1-Metal COF FILM	상장사
에드워드코리아	1,020,000 백만원	반도체용 펌프	상장사
(주)지니텍스	27,611 백만원	TOUCH IC, POWER IC, 터치패드모듈	상장사
(주)아스플로	88,390 백만원	반도체 배관부품	상장사
씨에스케이	230,000 백만원	반도체용 스크리버	상장사
온세미컨덕터 코리아(주)	635,000 백만원	반도체	상장사

# II 교육프로그램

## 01 교육과정

### 교육 프로그램 구성

- 실무 맞춤형 교육을 통한 현장실무형 인재 양성
- 몰입형 교육을 통한 중/고급 인재 양성
- 비이공계/비전공자를 위한 단계별 교육 프로그램(반도체WAVE교육과정) 구축 및 운영



# II 교육프로그램

## 02 이수체계 및 제도 개선

### 이수체계 및 제도 개선

#### 23년 개설 교과목 및 이수체계

모집부문	반도체 소재 트랙	반도체 소자/공정 트랙	반도체 설계 트랙	
개설과목	초급	공통: 반도체 기초공학 및 산업의 이해		
	중급	반도체 공정 소재 반도체 소재 합성 및 분석	MOS 소자 공학 반도체 공정 이론	디지털 IC 설계 아날로그 IC 설계

	계절 학기(동계)	4학년 1학기	계절 학기(하계)	4학년 2학기	계절 학기(동계)
몰입형	초급 (45h)		고급 1 (90h)	고급 2 (45h)	
교과형		중급 1 (45h)    중급 2 (45h)		고급 1	고급 2



#### 학사제도 개선

학사제도 명	개선 방향
집중 이수제	<ul style="list-style-type: none"> <li>계절학기/정규학기중 집중적으로 수업을 이수하고 학점을 취득하는 집중이수제 확대 추진</li> <li>2023년부터 부트캠프사업단 집중이수제를 도입하여, 실질적인 성과의 조속한 창출 도모</li> <li>인력양성사업에 근거 3과목 9학점으로 <b>마이크로전공</b> 부여</li> </ul>
이수학점 제한	<ul style="list-style-type: none"> <li>정규/계절학기 이수학점 상한 확대</li> <li>부트캠프 교과목 수강시 정규학기 및 계절학기 <b>3학점 추가 신청 가능</b></li> </ul>
성적평가	<ul style="list-style-type: none"> <li>타대생, 졸업생, 계열간 수강인원 확대 및 교육방법 혁신을 촉진하기 위해 그동안 유지했던 엄격한 상대평가 제도를 탈피하고 해당 강좌의 상당수를 <b>절대평가</b> 방식으로 전환 추진</li> </ul>
수강 및 학점인정	<ul style="list-style-type: none"> <li>프로젝트 수행형 교과목운영(예: 캡스톤디자인, 프로젝트 공모형)시 성과기반 학점 인정제 도입</li> <li>부트캠프 현장실습 진행시 실습주수에 따른 학점 인정</li> </ul>
계열간 수강신청 제한	<ul style="list-style-type: none"> <li>학문단위가 다른 계열간에도 의약대 등 특수학문단위를 제외하고는 자유로운 수강신청이 가능하도록 제도화</li> <li>반도체 기초과목 개설 통한 기본지식 습득 및 관련 규정 개정</li> </ul>
과목별 수강인원 제한	<ul style="list-style-type: none"> <li>원활한 수강신청과 강좌 수강 지원을 위하여 별도 수강T/O 부여 (분반 운영)</li> <li>구축된 온라인 강의 플랫폼 활용 및 온라인 강의 구축</li> </ul>

# II 교육프로그램

## 03 학생지원

### 학생지원

#### 참여학생 특전

#### 반도체WAVE융합 인재양성



마이크로디그리  
전공명기

몰입형-교과형 연계(호환) 교육 프로그램 연계로 **마이크로디그리** 인증 및 부전공학위 취득



마이크로디그리  
장학금 지급

마이크로디그리 및 부전공 이수 자중 성적우수자에 **장학금 지원**



현장실습 파견  
외부교육 지원

참여기업과 연계한 현장실습 프로그램 운영 및 KSIA, ETRI 등 다양한 외부교육 지원

#### 이수자 관리

- 취·창업센터 전문 상담사, 전임교수 상담을 통한 지원 체계
- 인문사회 커리어개발 센터를 통해 비전공자들을 위한 취업 지원 프로그램 운영
- 졸업생 CRM(고객 관계 관리)를 통한 추적 관리 및 지속 지원



반도체 소재 개발 및 분석 능력을 겸비한 융합 인재



반도체 소자 및 공정 개발 능력을 겸비한 융합 인재



최신 설계 기법을 활용 가능한 첨단 반도체 설계 인재

# III 사업단 소개 및 향후 일정



## 사업단 소개

### 반도체전문인력양성사업단

실무중심의 몰입형 교육을 통한 반도체 소재·소자/공정·설계  
첨단분야에 대한 실무형 『반도체WAVE인재』 양성



## 문의 및 연락처

- 주소  
죽전 경기도 용인시 수지구 죽전로 152 ICT관 331호  
천안 충남 천안시 동남구 단대로 119 공학관 304-2호
- E-mail  
죽전 [kseon2@dankook.ac.kr](mailto:kseon2@dankook.ac.kr)  
천안 [ssa1486@dankook.ac.kr](mailto:ssa1486@dankook.ac.kr)
- <https://cms.dandook.ac.kr/web/csd3>

## 향후 일정

- 수강 신청 : 10/11(수)~13(금) 수요조사 완료자 대상 별도 공지 메일/문자 발송 (강제입력)  
\* 자격요건 미달(6학기 이상 수료) 등의 사유로 선발시 제외될 수 있음
- 수강 실시 : - 초급교과 10월 중순 이후  
- 중급교과 (트랙별 1과목씩) 11월 말 이후





# Q & A